

PowerEdge R670



透過最佳化電源和平衡效能，提升資料中心效率。

提升資料中心效率和效能

Dell PowerEdge R670 是一款 1U、雙插槽機架式伺服器，專為高效能運算而設計，具備最佳電源效率和平衡效能，可提升資料中心生產力。它能平衡進階運算能力，且支援虛擬化、雲端原生應用程式、全快閃記憶體 SDS (軟體定義儲存)、超大規模工作負載和橫向擴充資料庫。

PowerEdge R670 專為企業級和可擴充基礎結構打造，提供易於整合至現有環境的標準化功能。搭載兩個具備 E 核心和 P 核心的 Intel® Xeon® 6 處理器，每瓦效能較前代機型提升高達 1.69 倍，改善電源效率並提高機架密度。加入 GPU 支援進一步提升運算能力，確保在降低能源使用的同時維持高效能。

這些伺服器提供後方 I/O 熱通道和前方 I/O 冷通道組態。前方 I/O 冷通道可改善檢修性，縮短維護時間，提升效率、可靠性和運作時間，透過最佳化冷卻和能源使用來支援您的永續發展目標。它還具備 Dell 的智慧電源與冷卻技術，針對氣體冷卻進行最佳化，可大幅降低能源消耗，有助於節省長期營運成本。

適用於零信任 IT 環境與作業的網路韌性架構

安全性已整合至 PowerEdge 生命週期的每個階段，包括受保護的供應鏈和原廠到府完整性保證。晶片式信任根可錨定端對端開機復原能力，而多因素驗證 (MFA) 和角色型存取控制則可確保受信任的作業。

透過自主協作提升效率並加速作業

Dell OpenManage 系統管理產品組合，能克服管理與保護 IT 基礎架構的複雜性。IT 可使用 Dell Technologies 直覺式端對端工具，透過減少程序和資訊孤島，藉此提供安全、整合的體驗，進而專注於拓展業務。Dell OpenManage 產品組合是創新引擎的關鍵，可充分發揮工具與自動化功能，協助您擴充、管理並保護您的技術環境。

永續發展

從產品和包裝中的回收材料，到精心設計的創新節能選項，PowerEdge 產品組合在製造、交付及回收產品方面的設計，有助於減少碳足跡並降低您的營運成本。有了 Dell Technologies，您甚至可以透過負責任的方式，輕鬆淘汰老式系統。

Dell Technologies Services 讓您更安心

透過全方位服務發揮 PowerEdge 伺服器最大效能，無論您身在何處都能滿足需求。使用 AI 專屬的專業服務讓高階 AI 使用案例加速創造價值，借助 ProDeploy Suite 選擇量身打造的部署選項，透過 ProSupport Suite 獲得主動式預測支援，加上我們在 170 個地點提供服務，並由 6 萬多位員工和合作夥伴提供支援。

PowerEdge R670

Dell PowerEdge R670 採用 Intel Xeon 6 處理器、DDR5 記憶體、NVMe BOSS、符合能源之星規範，並具備進階冷卻技術。適用於：

- 虛擬化
- 雲端原生應用程式
- 全快閃記憶體 SDS
- 超大規模工作負載
- 橫向擴充資料庫

注意：本文件提供完整的產品功能清單。但是，標有星號 (*) 的功能在產品推出時可能尚無法使用，會在未來的更新中加入。請注意，本文件並未確認任何功能的可用性或發佈時間表。如需功能可用性最準確且最新的相關資訊，請參閱 dell.com 上的產品組態工具頁面。

特性	技術規格	
處理器	兩個 Intel Xeon 6 處理器 (每個處理器最多 144 個 E 核心或 86 個 P 核心)	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> 32 個 DDR5 DIMM 插槽，最高支援 RDIMM 8 TB，速度最高可達 6400 MT/秒 僅支援暫存式 ECC DDR5 DIMM 	
儲存控制器	<ul style="list-style-type: none"> 內部開機：開機最佳化儲存子系統 (BOSS-N1 DC-MHS)：HWRaid 1，2 個 M.2 NVMe SSD 或 M.2 中介板 (DC-MHS)：2 個 M.2 NVMe SSD 或 USB 內部控制器：前側 PERC H965i、前側 PERC H975i、前側 PERC H365i 	
前側托架	<ul style="list-style-type: none"> 無底板組態 最多 8 個 EDSFF E3.S NVMe 最大 491.52 TB，亦搭配 FIO 組態 最多 16 個 EDSFF E3.S Gen5 NVMe，最大 983.04 TB 最多 20 個 EDSFF E3.S Gen5 NVMe，最大 1228.8 TB 最多 8 個 2.5 in SATA/NVMe Direct/NVMe Raid，最大 491.52 TB 8 個 2.5 in 通用 491.52 TB 最多 10 個 2.5 in SATA，最大 38.4 TB 後側最多 2 個 EDSFF E3.S Gen5 NVMe，最大 122.88 TB 	
熱交換電源供應器	<ul style="list-style-type: none"> 1500 W 鈦金級 100-240 VAC 或 240 VDC 1100 W Titanium 100—240 VAC 或 240 VDC 800 W Titanium 100—240 VAC 或 240 VDC 1100 W 白金級 100-240 VAC 或 240 VDC 800 W 白金級 100-240 VAC 或 240 VDC 1800 W HLAC Titanium 200—240 VAC 或 240 VDC* 1500 W 277 VAC 或 336 VDC* 1,400 W LVDC -48 — -60 VDC* 	
散熱選項	<ul style="list-style-type: none"> 氣體冷卻和直接液體冷卻 注意：DLC 是機架解決方案，需要機架多孔裝置和冷卻分配裝置 (CDU) 才能運作。 	
風扇	<ul style="list-style-type: none"> 高效能銀級 (HPR SLVR) 或標準 (STD) 風扇 最多 4 組 (雙風扇模組) 熱交換風扇 	
尺寸與重量	高：42.8 公釐 (1.69 吋) 寬：482 公釐 (18.98 吋) 重量：20.42 公斤 (45.02 磅)	深度 (適用於背面 I/O 組態) <ul style="list-style-type: none"> 816.92 mm (32.20 吋) 含外框 815.14 mm (32.09 吋) 不含外框 深度 (適用於前置 I/O 組態) <ul style="list-style-type: none"> 829.44 mm (32.66 吋) 不含外框 注意：前置 I/O 組態不支援外框。
外型規格	1U 機架式伺服器	
內嵌管理	<ul style="list-style-type: none"> iDRAC iDRAC direct 符合 Redfish 的 iDRAC RESTful API RACADM CLI iDRAC 服務模組 (iSM) Quick Sync 2 無線模組 NativeEdge 端點* NativeEdge Orchestrator* 	
外框	選配的防盜外框	
安全性	<ul style="list-style-type: none"> 透過密碼編譯的簽署韌體 資料重設加密 (使用本機或外部金鑰管理的 SED) Secure Boot (安全開機) 安全的元件驗證 (硬體完整性檢查) Secure Erase Silicon Root of Trust 系統鎖定 TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 認證 機箱入侵偵測 	
網路選項	2 張 OCP NIC 3.0 卡 (選配) 和 1 GbE、10 GbE、25 GbE、100 GbE 和 400 GbE* 插槽 31：前側擴充板 1 個 x16 OCP 3.0 插槽 32：前側擴充板 1 個 x16 OCP 3.0 插槽 2：1 個 x16 OCP 3.0 插槽 5：1 個 x8 Gen5 OCP 3.0 或 1 個 x16 Gen5 OCP 3.0	
BOSS	插槽 34：前側 BOSS 插槽或 插槽 3：後側 BOSS 插槽	
GPU 選項	最多 3 個 75 W SW	
DPU 選項	<ul style="list-style-type: none"> NVIDIA BlueField-3 2x200 GbE B3220 NVIDIA BlueField-3 1x400 GbE B3140H 	
連接埠	正面連接埠： <ul style="list-style-type: none"> 1 個 USB 2.0 Type-C 連接埠 1 個 USB 2.0 Type-A 連接埠 (選配) 1 個 Mini DisplayPort (選購) 1 個 DB9 序列 (搭配正面 I/O 組態) 1 個用於 iDRAC 管理的專用乙太網路連接埠 內部連接埠： <ul style="list-style-type: none"> 1 個 USB 3.1 Type A 連接埠 	背面連接埠： <ul style="list-style-type: none"> 1 個用於 iDRAC 管理的專用乙太網路連接埠 1 個 VGA 2 個 USB 3.1 Type-A 連接埠

特性	技術規格
PCIe	<ul style="list-style-type: none"> • 最多 2 個 x16 Gen 5 PCIe 插槽 • 插槽 31 · 前側擴充板 1 個 x16 全高 - 半長或全高 - 全長或 1 個 x16 OCP 3.0 • 插槽 32 · 前側擴充板 1 個 x16 全高 - 半長或全高 - 全長或 1 個 x16 OCP 3.0 • 最多 3 個 x16 或 2 個 x 8 Gen5 PCIe 插槽 • 插槽 1 · 1 個 x16 全高 - 半長或全高 - 全長或 3 個 x16 或 1 個 x 8 短版 - 半長 • 插槽 2 · 1 個 x16 或 1 個 x8 短版 - 半長或 1 個 x16 OCP 3.0 • 插槽 4 · 1 個 x16 全高 - 半長或 1 個 x16 短版 - 半長
作業系統和 Hypervisor	<ul style="list-style-type: none"> • Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server 具備 Hyper-V (僅限 P 核心) • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi • Dell NativeEdge 作業系統* <p>如需規格和互用性詳細資料，請參閱 Dell.com/OSsupport</p>
提供 OEM 版本	從邊框、BIOS 到包裝，您可以讓伺服器的外觀與風格就像由您親手設計及打造一般。如需更多資訊，請造訪 Dell.com -> 「解決方案」 -> 「OEM Solutions」。

標有星號 () 的功能在產品推出時可能尚無法使用。請參閱 Dell.com 的產品組態工具頁面，以確認功能可用性。

注意：從邊框、BIOS 到包裝，我們的 OEMR 平台可讓您的伺服器呈現彷彿由您親自設計和打造的外觀與質感，而 XL 平台則為 OEM Solutions 客戶提供延長的轉換期和穩定性。如需更多資訊，請造訪 Dell.com -> 「解決方案」 -> 「OEM 解決方案」。

APEX Flex on Demand

取得您需要的技術來支援不斷變化的業務，付款方式可依實際使用情況調整。如需更多資訊，請造訪 <https://www.delltechnologies.com/en-us/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm>。

深入探索 PowerEdge 伺服器



深入瞭解
PowerEdge 伺服器
的服務



深入瞭解我們的系統
管理解決方案



搜尋我們的
資源庫



在 X (先前稱為
Twitter) 上追蹤
PowerEdge 伺服器



聯絡 Dell Technologies
專家以獲得銷售協助或
技術支援